**※ICEPでの発表を元にした論文の場合は、発表番号と発表年を記載ください。**

**Trans. JIEP執筆例(本文ファイル)：**

Yohei Wakuda, Yoshiyuki Okura, Koichiro Kawate, Hideaki Yasui, Mitsuhiro Watanabe, Ichiro Koiwa, Hideo Honma：“A Method to Connect Flexible Printed Circuits and Indium Tin Oxide Electrodes Using Non-Conductive Film and Plating,”　Vol. **1,** No. 1, pp. 1-4, Dec, 2008を例として入れております。　※提出時はこのテキストボックスを削除してください。

**ICEP発表番号：**

**ICEP発表年：**

**論文分野(「大分類（：小分類）」の形で、2つまで入力ください)：**

材料技術：有機材料，部品内蔵技術

**※[分野一覧表はこちら](https://j-jiep.information.jp/wp-content/uploads/2019/07/t_bunya2019.pdf)**

**英文タイトル：**

A Method to Connect Flexible Printed Circuits and Indium Tin Oxide Electrodes Using Non-Conductive Film and Plating

**ランニングタイトル(空白を含む70文字以内。下の例は45文字になります)：**

A Method to Connect Flexible Printed Circuits

**ABSTRACT(50～200 語)：**

An improved method for～～.

**Keywords(5～10個)**：

Non-Conductive Film, Flexible Printed Circuits, ～～

**著者情報(**お名前，所属，所属先住所**)：**

Yohei Wakuda 1, Yoshiyuki Okura 2, Koichiro Kawate 2, Hideaki Yasui 2, Mitsuhiro Watanabe 3, Ichiro Koiwa 1 and Hideo Honma 1

1 Kanto Gakuin University, 1-50-1, Mutsuurahigashi, Kanazawa-ku, Yohohama-shi, Kanagawa 236-8501, Japan

2 ～～(別の所属の方がいらっしゃる場合、番号で区別してください)

**責任著者(Corresponding Author)情報**

(Name)XXXX XXXX

(E-mail) xxxxx@xxx.xx.xx

※Corresponding Authorは1名です。氏名をお知らせください(必須)。

※E-mailは任意です。Emailアドレスを記載いただいた場合、誌面に掲載いたします。

**本文(Information for Authorsをご確認ください。2段組にせず執筆ください。)：**

**1．Introduction**

As electronic devices become multi-functionalized～～using NCF.[1, 2]

・PDFで審査を行いますので、図表はなるべく見やすい大きさで提示ください。

　※表はテキストが抽出できる形式で作成・提出ください(Word、Excel、PowerPointなど)

※図はなるべく解像度が高いものを、別ファイルでも提出ください。

Table 1　xxxx

|  |  |
| --- | --- |
| A | 1111 |
| B | 2222 |
| C | 3333 |

(グラフなど)

Fig. 1　xxxxx

**文献(Information for Authorsをご確認ください)**

**References**

[1] H. Suzuki, Y. Ikuta and M. Kawabata, “Junction of the Flexible Printed Circuit using Anisotropic Conductive

Film”, Proceedings MES2003, pp. 352–355, 2003. [2] H. Kristiansen and A. Borneklett, “Finepitch connection to rigid substrate using nonconductive epoxy adhesive”, J. Electronics Manufacturing, Vol. **2**, pp. 7–12, 1992.

**Figure captions(図表キャプションのリストをつけてください)**

Fig. 1 Schematic model of dendric plating method.

Fig. 2 ~~

**著者紹介**

(著者様のお写真と90語程度の紹介文を掲載できます。写真の掲載を希望しない，または著者紹介の掲載を希望しない場合はその旨をご記入ください)